

SDV CONCEPT von SECOR verändert die Entwicklung und Nutzung von Chips im Fahrzeug grundlegend

Gräfelfing, den 17. Februar 2025 – Auf der Embedded World 2025 stellt SECOR sein SDV CONCEPT (Software Defined Vehicle) vor, das die Automobilindustrie fundamental verändern könnte. Das Startup, hinter dem geballte Fahrzeug- sowie IT-Kompetenz steht, hat einen standardisierten Halbleiter entwickelt, der durch Software konfigurierbar und somit universell einsetzbar ist. Das bedeutet: Der Chip kann für verschiedene Funktionen im Auto genutzt werden – für den Fensterheber genauso wie für die Motorsteuerung.

Wie der Chip verwendet wird, bestimmt allein die Software. Diese kann auch im Nachhinein Over-the-Air aufgespielt werden, um neue Funktionen zu ermöglichen. Sollten Leistung und Arbeitsspeicher im ausgelieferten Fahrzeug nicht mehr ausreichen, lässt sich der Chip außerdem dank Pin-Kompatibilität problemlos durch einen leistungsstärkeren austauschen. Für die Hersteller bedeutet das SDV CONCEPT von SECOR Kostenersparnis, kürzere Entwicklungszeiten und höhere Resilienz in Krisenzeiten.

Mehr Resilienz für die Automobilhersteller: mit patentiertem SDV CONCEPT

Bisher werden Chips in der Automobilbranche individuell für einen Kunden und für eine bestimmte Funktion entwickelt. Das kann zu Problemen in der Produktion führen. Ist ein bestimmter Halbleiter nicht verfügbar, steht die gesamte Fertigung still. Wie schnell dies gehen kann, haben zum Beispiel Lieferengpässe nach der Covid-Pandemie oder bei der Blockade des Suezkanals durch ein quergestelltes Container-Schiff gezeigt.

Mit dem zum Patent angemeldeten SDV CONCEPT stellt SECOR den OEMs eine Lösung bereit, um für solche Krisen künftig gewappnet zu sein. Da die Chips von SECOR standardisiert sind und lediglich die Software darüber entscheidet, für welche Funktion sie genutzt werden, reduzieren Hersteller ihre Komplexität und sind wesentlich flexibler in Fertigung sowie Entwicklung.

Mit zonalem Konzept die E/E-Architektur neu gedacht

Hinzu kommt: SECOR denkt die E/E-Architektur vollkommen neu. Statt – wie sonst üblich – mit einer riesigen Zahl von verschiedenen Electronic Control Units (ECU) für die unterschiedlichen Funktionen im Fahrzeug zu arbeiten, setzt SECOR auf ein zonales Konzept. Das bedeutet: Ein zentraler Rechner kommuniziert mit wenigen ECUs, die auf verschiedene Zonen im Auto verteilt sind und in welche die Standard-Chips verbaut sind. „Statt wie bisher 150 ECUs hat man dann nur noch fünf bis zehn“, sagt Klaus Jungbauer, Geschäftsführer von SECOR.

Mehr Flexibilität durch modulare und standardisierte Software

Fahrzeughersteller sind somit nicht nur flexibler, sondern benötigen insgesamt auch weniger Halbleiter. Modulare und standardisierte Software-Pakete beschleunigen außerdem den Entwicklungsprozess bis zum Start der Serienproduktion (SOP). Und falls der OEM vor dem SOP bemerken sollte, dass die Leistungsstärke des ursprünglich geplanten Chips nicht ausreicht, lässt sich dieser dank Pin-Kompatibilität einfach kurzfristig austauschen. „Das kann man sich wie bei einem 486-PC von IBM vorstellen, den man vielleicht noch von früher kennt.“

Bei diesem konnte man auch bei Bedarf manuell den Arbeitsspeicher erweitern“, erklärt der Geschäftsführer, Klaus Jungbauer. Das fördert außerdem die Nachhaltigkeit, weil die Fahrzeugelektronik auch im After Sales immer wieder entweder durch Software-Updates Over-the-Air oder durch einfachen Austausch der Chips auf dem aktuellen Stand bleibt. Die entsprechenden Autos können so länger genutzt werden.

Kostengünstiger, schneller und resilienter für die Automobilbranche

SECOR wird die Chips in mehreren Fabriken auf unterschiedlichen Kontinenten fertigen lassen. Auf diese Weise ist eine kontinuierliche Versorgung mit Halbleitern gewährleistet – unabhängig von geopolitischen Entwicklungen. „Mit unserem SECOR SDV CONCEPT machen wir die Entwicklung und Produktion von Fahrzeugen kostengünstiger, schneller und resilienter“, fasst Jungbauer zusammen. „Damit können wir der Gamechanger für die Automobilindustrie sein.“

Premierenvorstellung auf der embedded world 2025

Auf der embedded world 2025 (Halle 2, Stand 637g) in Nürnberg wird SECOR seine Technologie erstmals der Öffentlichkeit vorstellen. Am Beispiel einer Fahrzeugtür werden die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten der Chips demonstriert. Auf der Messe wird SECOR mit seinem Geschäftsbereich Chips & Library vertreten sein. Zur SECOR Gruppe gehört daneben auch die Geschäftseinheit SECOR Supply Chain Transparency GmbH (www.secor-sct.com), die Unternehmen aus der Automobilbranche eine Software as a Service anbietet, mit der sich prüfen lässt, wie resilient ihre aktuelle Produktion bereits ist. Bei Bedarf können Maßnahmen implementiert werden, wie Bauteilvergabe mit standardisiertem Resilience Score.

SECOR arbeitet außerdem mit einem Entwicklungspartner zusammen. Ziel ist, gemeinsam ein SECOR SDV CONCEPT CAR auf Basis des SECOR SDV CONCEPTs zu entwickeln, das in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt werden soll.

Über die SECOR Chips & Library GmbH

Die SECOR Chips & Library GmbH (www.secor-cl.com) gehört zur SECOR Group GmbH (www.secor.group). Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel und dem Vertrieb von Computern, Computersystemen, Hard- und Software jedweder Art im In- und Ausland. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Automobilindustrie. Für diese produziert SECOR Chips & Library GmbH unter anderem Chips und Software, die auf die speziellen Bedürfnisse der Automotive-Unternehmen zugeschnitten sind.

Pressekontakt

Klaus Jungbauer, Gründer und Geschäftsführer
SECOR Chips & Library GmbH
Tel: +49 89 89 99 75 13 07
Mobil +49 176 2325 0952
E-Mail: press@secor.group